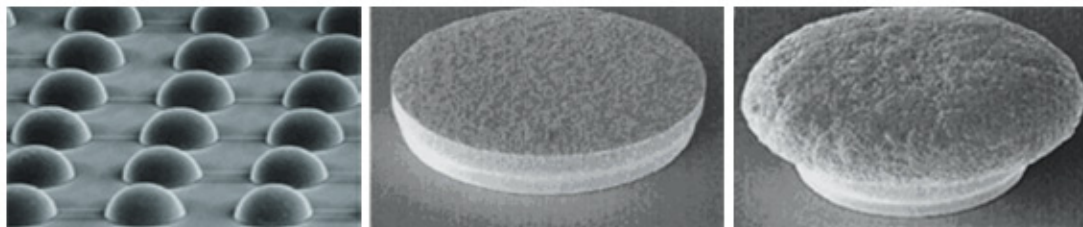


## JDQ 系列晶圆电镀设备



JDQ 系列晶圆电镀设备是我所根据国内微组装行业需求开发的湿法电镀设备。该产品主要用于 100mm~200mm 半导体晶圆上 Au、Cu、PbSn、AgSn 等不同材料的湿法电镀工艺。

### 主要技术特点：

- ※ 采用 PLC+10" 液晶触摸屏实时监控，可存储多种工艺菜单
- ※ 采用双脉冲电镀电源
- ※ 有多种镀制方式、多种镀槽结构可供选择
- ※ 整机采用模块化结构，镀槽数量可根据用户要求进行扩展
- ※ 镀液连续循环过滤，流量变频控制
- ※ 镀液温度、液位、PH 值自动监控
- ※ 高压 DI 水预浸润消泡功能
- ※ 去离子水注入、排放、冲洗功能
- ※ 镀液氮气保护
- ※ 故障诊断、显示、报警功能

### 主要技术指标：

- 双脉冲电源：量程 1A~3A，80V；精度 1mA
- 镀液循环流量：5lpm~30lpm
- 镀液过滤精度：0.5um
- 镀液温度：室温~60℃±1℃
- 处理片数：水平喷镀、倾斜旋转喷镀，1 片/槽；垂直挂镀，2 片/槽
- 沉积速度：0.5um/min~1.5um/min
- 整机功率：8kw